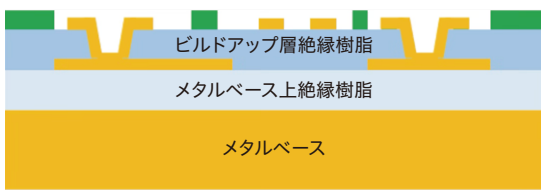
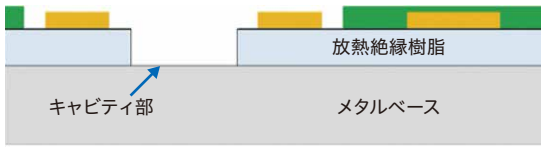

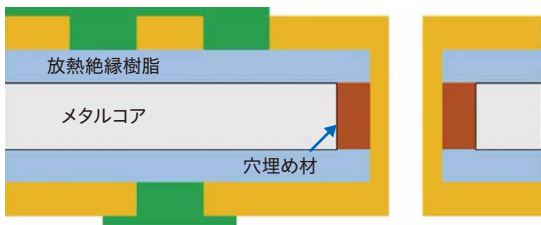
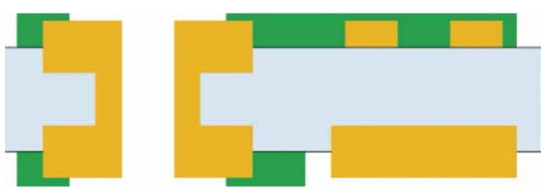


放熱構造基板ラインナップ

Heat dissipation PCB structure Line-up

特長 Features

- 大電流・高放熱など用途に応じて最適な基板構造をご提案します。

構造	特長
 <p>放熱樹脂ビルドアップ基板</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● メタルベース基板上に放熱絶縁樹脂、導体層を積層し、非貫通ビアで層間接続 ・ 対応導体厚： 外層 ~0.3mm 内層 ~0.2mm ・ メタルベース：銅 ・ ビルドアップ層絶縁樹脂はM2P、H5Tを使用
 <p>メタルベースキャビティ基板</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 基板に部品放熱用途のキャビティ構造を形成 ・ キャビティ部への部品実装で低背化が可能 ・ 熱伝導率の高い材料へ直接放熱が可能 ・ メタルベース：銅 or アルミ
 <p>厚銅狭ギャップ基板</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 厚銅回路のギャップ狭小化により、高密度／大電流に対応 ・ 導体厚 0.8~2.0mm ・ アスペクト比^{*1}：1.0以下 ・ エッチファクター^{*2}：10.0以上 ※1：間隙幅／導体厚 ※2：(2×導体厚)／(Top間隙幅 - Bottom間隙幅)
 <p>メタルコア基板 (アルミ、銅)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● メタルの埋め込みで放熱 ・ コア層のヒートスプレッド効果により放熱性向上 ・ 両面実装が可能 ・ 穴埋め材はインク充填又は絶縁樹脂層と兼用 ・ コア：銅 or アルミ 銅コアは厚みを薄くしてもアルミコア基板と同等の放熱効果 例：銅コア厚み 0.4mm、アルミコア厚み 1.2mm
 <p>複合銅厚基板 R&D</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 大電流回路と制御回路を同一層に形成 ・ 放熱／大電流部は導体厚を厚くして対応 ・ 制御回路部は導体厚を薄くし、回路密度を高くすることが可能 ・ 外層レジスト対応可能